## 证券简称: 深科技

# 深圳长城开发科技股份有限公司 2024年9月4日投资者关系活动记录表

编号: 2024-005

投资者关系 活动类别	√特定对象调研	□分析师会议
	□媒体采访	□业绩说明会
	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	
	□其他( <u>请文字说明其他活动内容)</u>	
参与单位名称 及人员姓名	中国人保资产 中信证券 中欧瑞博 华能贵诚信托	
时间	2024年9月4日	
地点	公司本部会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书钟彦,证券事务代表刘玉婷	
投资者关系活动主要内容介绍	本次会议主要介绍了公司概况、发展历程、全球布局、核心竞争优势	
	以及产品与业务,并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业	
	务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。	
	一、公司基本情况介绍	
	公司是全球领先	的专业电子制造企业, 连续多年在MMI
	(Manufacturing Market Insider) 全球电子制造服务行业(Electronic	
	Manufacturing Service, EMS) 排名前列。公司专注于为客户提供技术研	
	发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制	
	造服务。以先进制造为基础,以市场和技术为导向,公司坚持高质量发展,	
	构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战	
	略。	
	二、交流环节	
	1. 公司2024年半年	度的经营情况表现如何?

答:2024年上半年,公司实现营业收入70.55亿元,同比下降8.86%; 实现利润总额5.72亿元,同比增加23.49%; 实现扣除非经常性损益后的归母净利润3.45亿元,同比增加30.06%。其中,存储半导体业务实现收入17.76亿元,占营业收入的25.17%; 计量智能终端业务实现收入13.18亿元,占营业收入的18.69%; 高端制造业务实现收入39.25亿元,占营业收入的55.63%。

### 2. 2024年半年度整体毛利率增长情况?

答:公司2024年上半年整体毛利率为16.56%,毛利率较去年同期略有上升,增长了2.68%。由于产品业务结构调整,公司收入下降的情况下利润有所增长。

### 3. 目前深圳沛顿和合肥沛顿情况如何?是否有扩产计划?

答:公司半导体封测业务以深圳、合肥半导体封测双基地的模式运营。2024年上半年,公司积极导入新客户、完成现有客户新产品的设计开发和验证,双基地产能产量持续提升。为实现高阶、大容量存储芯片封装,公司积极布局高端封测。2024年上半年,公司规划布局的Bumping(微凸点)项目于2024年7月初成功完成客户可靠性验证,正式开始量产。未来,公司将以满足重点客户产能需求和加强先进封装技术研发为目标,聚焦Sip封装技术和xPOP堆叠封装技术和车规级产品设计规范的建立,致力成为存储芯片封测标杆企业。2024年上半年,业务收入较去年同期有较高增长。公司目前订单情况正常,产能可以满足客户需求,且有扩产计划。

#### 4. 公司如何展望未来经营业绩情况?

答:公司董事会及经营管理层通过聚焦主责主业持续提升核心竞争力、优化体制机制激发企业活力、完善合规风控体系建设加强防御风险能力,通过精益化管理,持续提高运营效率,降低管理成本,提升盈利水平。未来,公司将加强科技创新,着力形成新质生产力,聚焦主责主业,着力提高发展质量,贴近客户需求,着力提升产供链韧性和效能,打破思维惯性,着力优化适应高质量发展的生产关系,以进一步提升盈利水平,为股东创造价值和回报。

	接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息	
	披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等	
	情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。	
附件清单 (如有)	无	
日期	2024年9月4日	